

## 技术参数

# G5002

日期 : 06/2011  
上海禧合应用材料



### 应用介绍

#### 特点

一款单组份环氧粘接剂，适用于贴片工艺而开发的胶水，具有固化速度快，对 FR4 和其它的一些接触面粘接强度高等特点，可以大规模的应用于贴片工艺。

#### 粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃，陶瓷等

#### 典型应用

芯片贴合粘接

### 固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	浅黄	
粘度(cps)	10380	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件*	1.5mins@150°C	
比重	1.12g/cm <sup>3</sup>	
有效期@ -5°C,月	6	

\*固化温度是指实际到达胶水表面温度

### 固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	琥珀色	
粘接强度 MPa	≥11	铝+铝
邵氏硬度	80D	ASTM D-2240
玻璃化温度 Tg	108°C	DSC
降解温度	388°C	

可靠性	数值	测试方法
固化失重	<1.5%	
工作温度范围	-60°C—150°C	

### 储存和使用方法

产品低于-5°C冷冻环境中保存。使用前需要从冰箱拿出，30ml 室温下解冻 2 小时方可使用；大包装需要更长时间解冻；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件

#### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

[www.stick1mat.com](http://www.stick1mat.com)

Email: [info@stick1mat.com](mailto:info@stick1mat.com)

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

